



高性能4通道、8通道SPI NOR Flash



4通道产品 LT/T系列

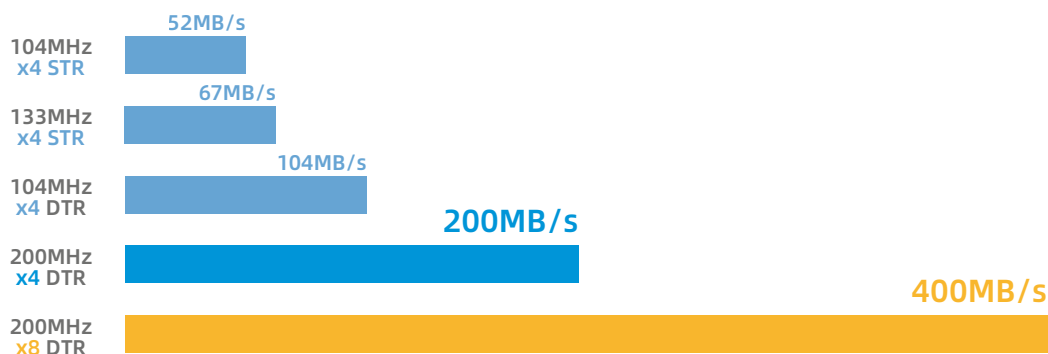
- ◆ 1.8V 256Mb~2Gb、3V 512Mb~2Gb
- ◆ 单通道SPI、4通道DTR SPI接口
- ◆ 兼容4通道SPI指令集
- ◆ 极高的读取性能，高达200MB/s数据吞吐量
- ◆ 支持XIP(Execute-In-Place)
- ◆ DQS和DLP特性来优化高速性能
- ◆ 支持ECC和CRC功能，提高可靠性和I/O完整性
- ◆ 支持标准TFBGA24、SOP16、WSON8封装



8通道产品 LX/X系列

- ◆ 1.8V 256Mb~2Gb、3V 512Mb~2Gb
- ◆ 单通道SPI、8通道DTR SPI接口
- ◆ 兼容JEDEC xSPI标准
- ◆ Xccela™ Flash联盟成员
- ◆ 极高的读取性能，高达400MB/s数据吞吐量
- ◆ 支持XIP(Execute-In-Place)
- ◆ DQS和DLP特性来优化高速性能
- ◆ 支持ECC和CRC功能，提高可靠性和I/O信号完整性
- ◆ 支持标准TFBGA24、SOP16、WLCSP封装

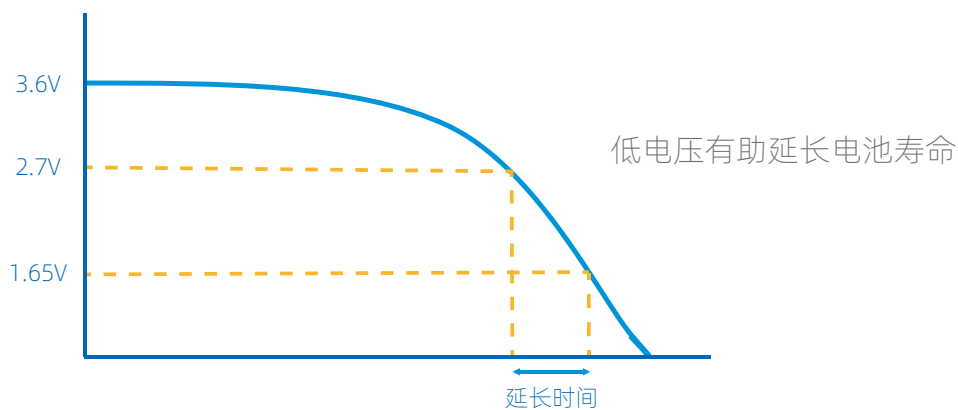
SPI NOR Flash读取性能





超低功耗、宽电压SPI NOR Flash

兆易创新全新的超低功耗SPI NOR Flash GD25Wx系列支持宽电压工作，是可穿戴设备、IoT、电池供电应用的理想之选。



主要特性



1.65V
~
3.6V



深度睡眠
零耗电0.1uA



单通道
双通道
四通道
SPI模式



读电流
3.5mA



写电流
15mA



512Kb
~
256Mb



USON6
或WLCSP
封装





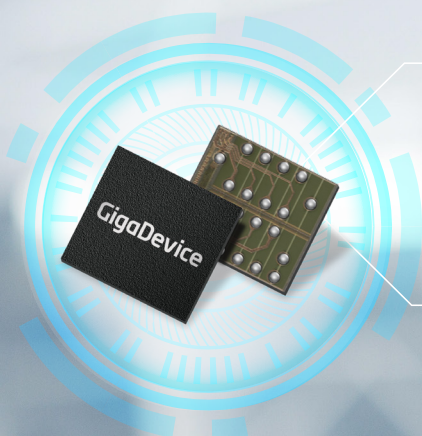
SPI NOR Flash 系列

超小封装

兆易创新推出全新的低功耗SPI NOR Flash系列，采用了USON6(1.2 mmx1.2 mm)和WLCSP封装，为物联网(IOT)设备、可穿戴设备、智能手机以及各种紧凑型电池供电应用提供了极大的设计灵活性。

- ◆ 支持1.65V~3.6V宽电压工作
- ◆ 提供单通道、双通道、四通道SPI模式
- ◆ 提供从512Kb~256Mb的不同容量选择
- ◆ 支持USON6(1.2 mmx1.2 mm)封装
- ◆ 工作频率高达104MHz
- ◆ 高可靠性，数据保留时间20年，编程/擦除周期达100000次
- ◆ 低功耗：
深度睡眠零耗电：0.1uA
以40MHz时钟工作时，读取电流低至3mA
- ◆ 高级安全功能：
128-bit UID
- ◆ 工作温度：
-40°C ~85°C, -40°C ~105°C, -40°C~125°C





WLCSP 封装技术

小尺寸、低功耗 让有限空间释放无限创意

随着可穿戴手环、智能手表、TWS耳机等一系列精致小巧的低功耗设备日渐风靡，对芯片尺寸的要求也越来越高。兆易创新采用WLCSP技术的芯片，长宽尺寸最小可以做到1mm之内，厚度最薄可以做到0.25mm，约是USON8 (3mmx2mm)封装尺寸大小的1/10。

兆易创新WLCSP封装的存储器件提供1.8V和1.2V低电压供电，1.8V读功耗最低只有7~10mA/166MHz，性能卓越，比行业水平低45%，1.2V支持Normal Mode和Low Power Mode两种工作模式，在Normal Mode下，读功耗最低6mA@120MHz x4I/O；在Low Power Mode下，读功耗最低0.4mA@1MHz x4 I/O，擦写功耗低至8mA，深度睡眠零功耗0.1uA，充分满足目前低功耗移动设备轻薄小、待机久的多维需求，让研发人员在系统方案设计中游刃有余。

